

杭州士兰微电子股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：杭州士兰集昕微电子有限公司（以下简称“士兰集昕”）。士兰集昕为本公司之控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年3月1日至2024年3月31日，公司在年度预计担保额度内为士兰集昕提供担保1.56亿元；

截至2024年3月31日，公司为士兰集昕实际提供的担保余额为10.38亿元；其担保余额在公司相关股东大会批准的担保额度范围内。

● 本次担保无反担保。

● 本公司不存在逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）年度预计担保进展情况

2024年3月1日至2024年3月31日，公司在年度预计担保额度内实际发生的担保如下：

担保合同名称	担保合同签署日期	保证人	被担保人	债权人	担保金额	担保方式
最高额保证合同	2024年3月11日	杭州士兰微电子股份有限公司	杭州士兰集昕微电子有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州钱塘支行	担保的债权最高余额为人民币1.56亿元及其利息、费用等	连带责任保证担保

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年3月29日召开的第八届董事会第六次会议和2023年4月20日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于本公司2023年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》，同意公司在2023年度对资产负债率为70%以下的主要全资子公司及控股子公司提供日常担保的总额度不超过32亿元，其中对士兰集昕提供日常担保不超过13亿元。以上担保预计金额包含以前年度延

续至 2023 年度的日常担保余额，且在 2023 年年度股东大会召开前，本公司为上述全资子公司及控股子公司在以上日常担保的总额度内所作出的担保均为有效。股东大会同时授权董事长陈向东先生审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日和 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号为临 2023-015、临 2023-021 和临 2023-029。

本次担保在上述股东大会批准的担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

（三）截至 2024 年 3 月 31 日，公司为士兰集昕提供的担保为日常担保，担保余额在公司 2022 年年度股东大会批准的担保额度范围内，具体如下：

（单位：人民币 亿元）

被担保人	年度预计担保额度	已实际提供担保额度	剩余可用担保额度
士兰集昕	13	10.38	2.62

二、被担保人基本情况

（一）被担保人的基本情况如下：

公司名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地	法定代表人	注册资本（万元）	本公司持股比例（%）		主营业务
						直接	间接	
杭州士兰集昕微电子有限公司	91330101MA27W6YC2A	2015 年 11 月 4 日	浙江杭州	陈向东	224,832.8735	47.73	32.35	芯片制造

（二）被担保人士兰集昕最近一年及一期的主要财务数据如下：

（单位：人民币 万元）

项目	2023年9月末/2023年1-9月 （未经审计）	2022年末/2022年度 （经审计）
资产总额	372,419	364,698
负债总额	162,496	155,402
净资产	209,923	209,296
营业收入	105,350	131,345
净利润	448	-1,720

（三）士兰集昕为本公司的控股子公司，其未被列为失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

担保合同名称	保证人	被担保人	债权人	担保金额	担保方式	担保期限
最高额保证合同	杭州士兰微电子股份有限公司	杭州士兰集昕微电子有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州钱塘支行	担保的债权最高余额为人民币 1.56 亿元及其利息、费用等	连带责任保证担保	主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年

上述担保无反担保。上述担保非关联担保。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保事项是为了满足控股子公司士兰集昕日常生产经营的资金需求，有利于公司主营业务的发展；被担保人士兰集昕为公司合并报表范围内的子公司，具备良好的偿债能力，风险可控。

五、董事会意见

公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第八届董事会第六次会议和 2023 年 4 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于本公司 2023 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日和 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号为临 2023-015、临 2023-021 和临 2023-029。

六、累计对外担保数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司批准对外担保总额为 51.566 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 69.94%。公司对控股子公司提供的担保总额为 41.98 亿元、控股子公司之间提供的担保总额为 1.37 亿元，合计占公司最近一期经审计净资产的 58.80%；公司为厦门士兰集科微电子有限公司提供的担保总额为 8.216 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 11.14%。公司及控股子公司均无逾期的对外担保事项。（担保总额包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。）

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2024年4月2日